

7月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要..... 4

一、宏观动态..... 6

二、半导体产业动态..... 9

三、 终端市场动态..... 18

 （一） 人工智能..... 19

 （二） 汽车..... 19

 （三） 医疗..... 20

 （四） 工业..... 21

 （五） 机器人..... 22

四、 存储行情..... 24

 （一） 存储行情概览..... 24

 （二） 存储品类/品牌现货市场价格趋势..... 24

信息来源..... 28

免责声明..... 33

摘要

2026 年 7 月重点行情趋势	
宏观动态	● 中东：美伊停火破裂，“双峡”封锁冲击全球半导体供应链 ● 美国：对 60 个贸易伙伴实施新一轮 301 关税，半导体器件获明确豁免 ● 美国：CHIPS 法案补贴密集落地，博世 2.25 亿美元签约、台积电千亿追加 ● 日本：熊本 7.1 级强震冲击“硅岛”，多家半导体企业停产排查 ● 中国：出口管制体系化升级——氦气禁令、AI 技术收紧与欧盟反制三箭齐发
产业动态	● 三星电子：Q2 完整财报营业利润暴增 1,814%，半导体 DS 部门贡献 99.7%集团利润，MLCC/DRAM/代工三线涨价 ● SK 海力士：Q2 财报双创新高但不及预期，HBM4 量产出货，LTA 与客户押金机制重塑存储供应链 ● 美光：DRAM/NAND 供应紧张，HBM 与企业级需求强劲 ● 南亚科技：Q2 净利+1,324%，毛利率 79.5%超越台积电 ● 台积电：打破“不提价”惯例，7 月即期涨 5-10%，2027 年再涨 ● 英伟达：GPU 供应紧缺，高端专业卡暴涨 50%+，交期 12-18 月 ● 超威半导体：Helios 全面投产，MI455X 正面挑战英伟达 ● 博通：AI 虹吸传统产能，PCI-E 与网络芯片结构性暴涨 ● 英特尔：Q2 营收创近 15 年最快增速，数据中心+59% ● 高通：9 月起涨价两位数，旗舰芯片成本突破\$300 ● 意法半导体：Q2 超预期，通用 MCU 与 AI 数据中心双引擎驱动 ● 德州仪器：Q2 全面超预期，三大市场强劲驱动 ● 瑞萨：7 月涨价落地，现货市场两极分化
终端市场	人工智能 ● Anthropic、OpenAI 与 AMD 锁定长期 AI 算力资源 ● 英伟达支持拟议的俄亥俄州 10GW AI 数据中心项目 汽车 ● 福特与通用锁定美光长期供货协议，保障下一代车型内存供应 ● Mobileye 为 Stellantis 提供 ADAS 技术，REM 覆盖美欧 95% 以上道路 医疗 ● ADI 发出供应链预警：医疗级模拟芯片交期延长至 6 个月 ● 北美医疗半导体市场面临进口高度集中的局面 工业 ● 瑞士工业原始设备制造商（OEM）转向人工智能加速芯片 ● ADI 与 TI 将工业模拟芯片产能转向 AI 领域；传统逻辑芯片进入停产（EOL）

	阶段 机器人 ● 继上海 IPO 获批后，宇树科技（Unitree）在欧洲推出 H1 Pro ● Foundation 选用 AMD Ryzen AI Embedded X100 打造 Phantom 人形机器人 ● AgiBot 扩大国内半导体应用
存储行情	● DRAM：Q3 合约价预计上涨 13-18%，供需缺口仍在加深 ● DDR4：供应收紧推动合约价格上行，但部分现货规格已现回落迹象 ● DDR5：颗粒报价上扬直接拉高内存条成本，叠加云服务商采购量增加，价格居高不下 ● NAND Flash：Q3 合约价涨幅受消费端放缓制约，预计在 10%-15%区间

一、宏观动态

● 中东：美伊停火破裂，“双峡”封锁冲击全球半导体供应链

7月上旬，6月签署的美伊谅解备忘录实质破裂，美军连续空袭伊朗，伊朗革命卫队于7月12日宣布关闭霍尔木兹海峡。截至7月20日当周，海峡船舶通行量骤降66%，7月23日仅一艘油轮通过，为5月以来最低。与此同时，也门胡塞武装于7月20日宣布对沙特实施海上禁运，并在红海袭击多艘沙特油轮，曼德海峡运输量同步下降近50%。两大能源咽喉同时受阻，全球原油与大宗商品供应链面临严峻挑战。对半导体产业而言，卡塔尔供应全球约三分之一的氦气，其出口高度依赖霍尔木兹海峡，而氦气在晶圆冷却、光刻及泄漏检测等环节不可替代。截至7月10日当周，氦气现货价格自3月以来已至少翻倍；中国氦气对外依存度高达84%，进口集中于卡塔尔（54%）和俄罗斯（44%）。受地缘风险升温影响，费城半导体指数7月累计下跌逾17%，7月17日正式进入技术性熊市，较6月22日历史高点回撤超20%，地缘冲突、能源成本上升与供应链不确定性三重压力集中释放，半导体板块估值持续承压。

● 美国：对60个贸易伙伴实施新一轮301关税，半导体器件获明确豁免

7月23日，美国贸易代表办公室依据《1974年贸易法》第301条发布正式公告，以所谓“强迫劳动”为由，对60个国家和地区加征10%至12.5%的新关税，以替代7月24日到期的10%全球临时进口关税。新关税于美东时间7月24日00:01正式生效。此次关税覆盖美国约99.4%的进口商品，税率分为四档。具体而言，对中国大陆、中国香港、越南、澳大利亚等38个经济体直接加征12.5%；对日本、韩国、瑞士按“补齐至MFN税率12.5%”方式征收；对欧盟、中国台湾按“补齐至MFN税率10%”方式征收；对英国、印度、加拿大等17个经济体直接加征10%。对行业影响：半导体器件因已受232条款关税约束，被明确列入豁免清单。新301关税与232关税不叠加，但与此前对华301关税叠加征收。在途货物若于7月24日前装船且7月28日前清关可免缴新关税。美国还在推进针对16个经济体的产能过剩调查，未来可能出现更多行业性关税。新关税出台后引发多国抗议——中国外交部表示反对各种形式的单边关税措施，关税战不符合任何一方利益；日本内阁官房长官称“深感遗憾”；澳大利亚副总理称此举“毫无道理”；欧盟因7月1日生效的美欧贸易协议获得15%关税上限保障，反应相对温和。

- **美国：CHIPS 法案补贴密集落地，博世 2.25 亿美元签约、台积电千亿追加**

7 月 13 日，美国商务部与博世签署 2.25 亿美元 CHIPS 最终资助协议，支持其投资 20 亿美元将加州工厂升级为 8 英寸碳化硅生产基地；同日特朗普签署公告，对半导体、医疗和先进制造领域的化工企业给予为期两年的 HON 规则合规豁免，保障关键化学品供应。7 月 16 日，台积电宣布追加对美投资 1000 亿美元，再建 4 座 2 纳米及以下制程晶圆厂及先进封装设施，累计投资达 2650 亿美元。政府补贴与企业投资形成双轮驱动，政策重心已扩展至材料保障、封装能力建设和先进制程本土化的全链条布局。7 月 15 日，美国国际贸易委员会对三星、谷歌、英伟达、博通等企业启动第二次 DRAM 相关 337 调查（调查编码：337-TA-1511），源于 Netlist 公司就 HBM 及 DDR5 相关专利提出的侵权申诉，凸显存储芯片领域知识产权保护持续升级。7 月 22 日，SEMI 率企业高管赴国会山紧急游说，敦促延长第 48D 条先进制造业投资税收抵免（AMIC）。该 35% 退税政策已推动全美 28 个州数千亿美元投资落地，但设施须在 2026 年 12 月 31 日前开工方能享受，SEMI 警告这一截止日期与半导体设施多年建设周期严重脱节。

- **日本：熊本 7.1 级强震冲击“硅岛”，多家半导体企业停产排查**

7 月 28 日 16 时 27 分，日本熊本县发生 7.1 级浅源强震，属走滑断层型直下型地震，震源深度约 10 公里，最大震度 7 级，菊阳町实测震度为 5 强。地震已致 14 人死亡、数十人受伤。九州半导体产值占日本全国 56.3%，汇聚台积电 JASM、索尼、瑞萨电子、东京电子等龙头企业。地震发生后，多家半导体企业启动应急措施并暂停生产：台积电 JASM 一厂（28/22nm、16/12nm 成熟制程，月产能约 2 万片 12 英寸晶圆）震后停机，供水、供电系统正常运作，原料供应无虞，但设备检查与校正需要一定时间；在建二厂一度暂停施工，现已恢复。台积电日本厂占其总产能不到 3%，评估对运营影响有限。索尼熊本技术中心是全球最大 CMOS 图像传感器生产基地（全球市占率 53%），计划 8 月 4 日起分阶段恢复运营，预计 8 月中旬恢复至震前产能。瑞萨电子锦工厂（天花板脱落、墙壁开裂）7 月 29 日晚已重启生产；川尻工厂（墙壁开裂、漏水，纯水供应中断）计划 8 月 5 日起分阶段恢复。东京电子两座厂区（涂布/显影、清洗及 3D 封装设备）厂房与核心设备无重大损坏，自 8 月 3 日起全面复工复产。三菱电机两座功率半导体工厂 7 月 30 日下午已恢复设备运转。物流方面，八代港是九州南部唯一能处理半导体制造危险物质的港口，已出现土壤液化和地面塌陷。行业研判认为本次停产以 3 至 7 天预防性检修为主，短期车规级成熟芯片报价或将出现 5%-15% 阶段性上浮；长远来看，本次地震暴露了单一区域产业集聚的供应链风险，或将加速全球半导体供应链向多元化、分散化布局转型。

● **中国：出口管制体系化升级——氦气禁令、AI 技术收紧与欧盟反制三箭齐发**

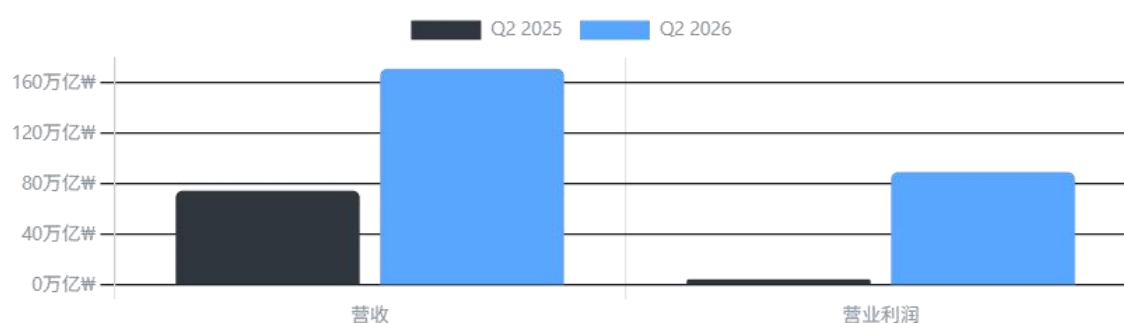
7 月，中国在半导体相关出口管制领域密集出手，呈现从单点管控向体系化布局升级的态势。原材料端，7 月 10 日商务部与海关总署发布 2026 年第 29 号公告，对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气在晶圆冷却、光刻及泄漏检测等半导体制造核心环节应用广泛，商务部 7 月 16 日回应称此举旨在保障国内供应，符合世贸组织规则，后续将根据国内外供需变化适时调整。规则端，7 月 21 日据英国《金融时报》报道，商务部正与阿里巴巴、字节跳动、智谱等企业磋商，研究收紧 AI 与半导体技术出口管制，可能涉及限制模型训练关键数据转移、模型权重下载及海外芯片代工等，新措施可能纳入下一版《中国禁止或限制出口技术目录》。反制端，7 月 24 日商务部发布 2026 年第 30 号公告，将 14 家欧盟实体列入出口管制管控名单，系对欧方 7 月 23 日将 14 家中国企业列入对俄制裁清单的快速反制。被列入名单的实体涵盖半导体材料研发、红外探测、永磁电机和特种化工等领域。整体来看，中国正从“应对他国出口管制”转向“主动设置技术边界”，在关键原材料、前沿 AI 技术和贸易反制三个维度同步推进出口管制体系化升级。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
厂商	类别	核心数据	趋势
三星 Samsung	存储/MLCC/ 代工	OP 89.49T (+1,814%), 净利 71.27T; DS 部门占集团利润 99.7%; MLCC +30%, DRAM +20%	三线齐涨
SK 海力士 SK Hynix	存储	Rev 79.32T (+257%), OP 60.54T (+557%), 净利 93.9T (+1,242%, 含重大非经常性投资收益); HBM4 量产达 HBM3E 良率	LTA 锁定
美光 Micron	存储	DDR4 8Gb ~\$70, DDR3 4Gb >\$13; 消费级产能受挤压	价格持续上行
南亚科技 Nanya Technology	存储	Q2 Rev 825 亿 TWD (+684%), GM 79.5% 超台积电; ASP QoQ +60%	DRAM 超级周期
台积电 TSMC	代工	3/5/7nm 即期 +5-10%, 2027 再涨 +5-10%, HPC 溢价 10-15%	打破惯例, 卖方定价
英伟达 NVIDIA	GPU	RTX Pro 6000 +50%, 交期 12-18 月; 高端产能优先 AI DC	高端紧缺
超威半导体 AMD	GPU/AI	Helios 2.9 exaFLOPS; Anthropic 2GW 部署; AI TAM → \$2T	吉瓦级挑战英伟达
博通 Broadcom	网络/PCI-E	PCI-E 5.0+ 交期 >52 周; SS05 翻 2-3×, BCM54616 翻 10×	结构性暴涨
英特尔 Intel	服务器 CPU	Q2 Rev \$161 亿 (+25%), DCAI \$63 亿 (+59%), 15 年最快增速	需求超供应
高通 Qualcomm	手机 SoC	9/1 +>10%; 骁龙 8 Elite Gen 6 >\$300; 手机出货 -11%	成本传导终端
意法半导体 ST	模拟/MCU	Q2 \$34.9 亿 (+26%), MCU +35.5%; book-to-bill ~2, 交期 30→52 周	双引擎驱动
德州仪器 TI	模拟	Q2 \$54.63 亿 (+23%); 工业 +30%, DC 翻倍; 指引 \$56.5-61.5 亿	全面超预期
瑞萨 Renesas	MCU/车规	全品类 +8-15% (年内第二次); 车规溢价 15-30%, 通用价跌	两极分化

● **三星电子：Q2 完整财报营业利润暴增 1,814%，半导体 DS 部门贡献 99.7%集团利润，MLCC/DRAM/代工三线涨价**

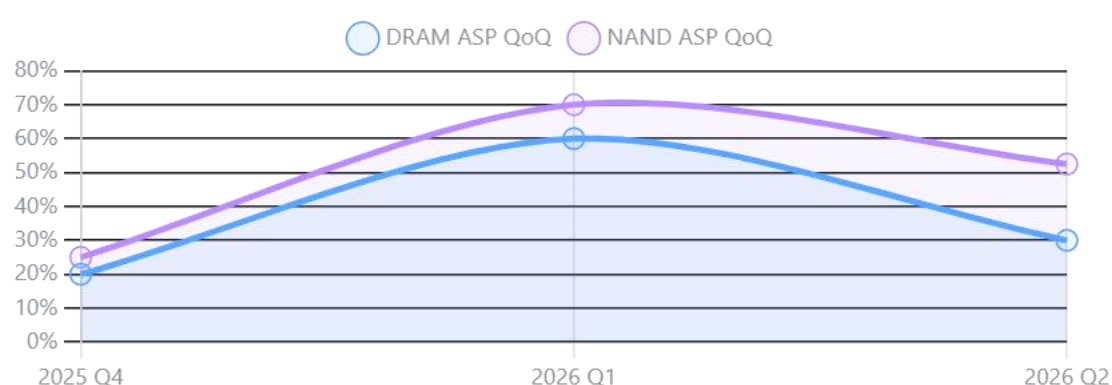
7 月 30 日完整财报：Q2 销售额 171.50 万亿韩元（+130%），营业利润 89.49 万亿韩元（+1,814%），净利润 71.27 万亿韩元超预期。DS（半导体）部门销售额 127.5 万亿韩元、营业利润 89.2 万亿韩元，占全集团利润 99.7%——AI 驱动 DRAM 与 NAND 位出货量均创新高，服务器营收占比刷新纪录。HBM4 客户验证接近完成，Q3 销售额预计季增逾三倍，下半年 HBM4 占整体 HBM 比重突破 60%；已向主要客户送出业界首批 HBM4E 样品并洽谈 2027 年供货。NAND 方面，服务器 SSD 占 NAND 营收比重超 60%（较去年+20 个百分点），V10 V-NAND 采用三层堆栈架构预计 8 月量产。涨价方面：MLCC 8/1 起全线涨 30%、Q3 通用 DRAM 目标涨 20%、代工 4/5/8nm 对新客户涨 15%。7 月 25 日与博通签署至 2030 年 2,000 亿美元 MOU。整机 DX 部门亏损 8,000 亿韩元，AI 半导体与消费电子分化显著。股价较 6 月历史高点回落逾 40%，反映市场对 AI 资本支出回报的疑虑。



● **SK 海力士：Q2 财报双创新高但不及预期，HBM4 量产出货，LTA 与客户押金机制重塑存储供应链**

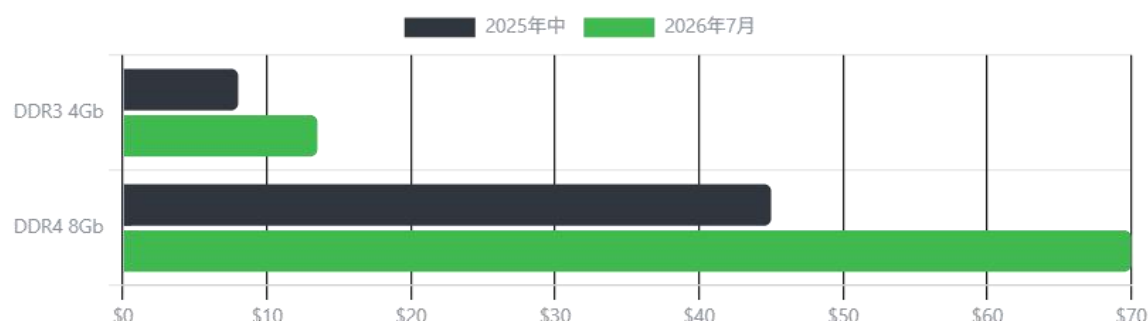
7 月 29 日 Q2 财报：营收 79.32 万亿韩元（+257%），营业利润 60.54 万亿（+557%），净利润 93.9 万亿韩元（+1,242%，含重大非经常性投资收益），均创纪录但低于分析师预期（营业利润约 64 万亿），股价单日暴跌 14.65%。核心原因是相较 Samsung

采取更保守的定价策略，尤其在 LTA 下削弱了现货价格上涨的收益弹性。业务层面，HBM4 Q2 量产出货且良率达 HBM3E 成熟水平；iHBM 通过混合键合内置冷却元件，热阻降 30%；321 层 NAND 产量占比最高。已与约 10 家核心客户敲定多年 LTA（含客户押金机制），覆盖约 50%总产能。资本支出上调至 high-40 万亿韩元。7 月 25 日，NVIDIA 正式宣布与 SK 海力士达成多年期 AI 内存供应协议，潜在价值高达 5000 亿美元。



● 美光：DRAM/NAND 供应紧张，HBM 与企业级需求强劲

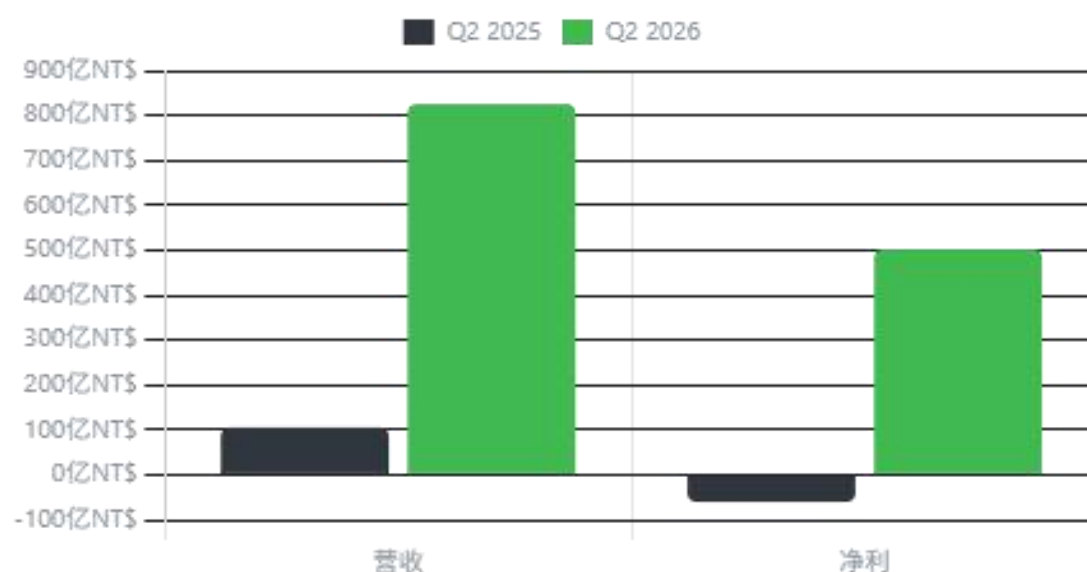
DDR4 8Gb 约 70 美元，DDR3 4Gb 突破 13 美元。HBM 与企业级 SSD 需求强劲，消费级产能受 AI 挤压。美光与三星、SK 海力士趋势一致——优先将产能分配给高利润的 AI 服务器和 HBM 产品线，消费级 DRAM 和 NAND 供应持续偏紧。1 β DRAM 和 232 层 NAND 已量产，但产能向高端倾斜的结构性问题短期内难以缓解。



● 南亚科技：Q2 净利+1,324%，毛利率 79.5%超越台积电

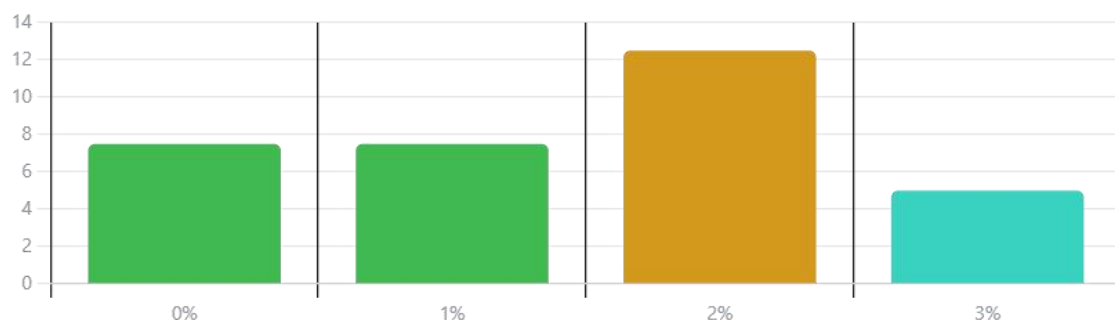
7 月 10 日法说会：Q2 营收 825 亿新台币（+684%），毛利率 79.5%创历史新高并超

越台积电。DRAM ASP 环比大涨超 60%为业绩爆发主因。总经理李培瑛指出 AI 正推动存储产业进入结构性成长，AI 占用大量先进产能挤压传统 DRAM 供给，预计全球 DRAM 供不应求延续至 2028 年。公司宣布 2027 年资本支出超 2,000 亿新台币，新建 5A 晶圆厂导入 1C/1D 制程，2028 年月投片 3 万片，LTA 占总产能 50%。南亚科技的强劲业绩是当前 DRAM 超级周期的缩影。



● 台积电：打破"不提价"惯例，7 月即期涨 5-10%，2027 年再涨

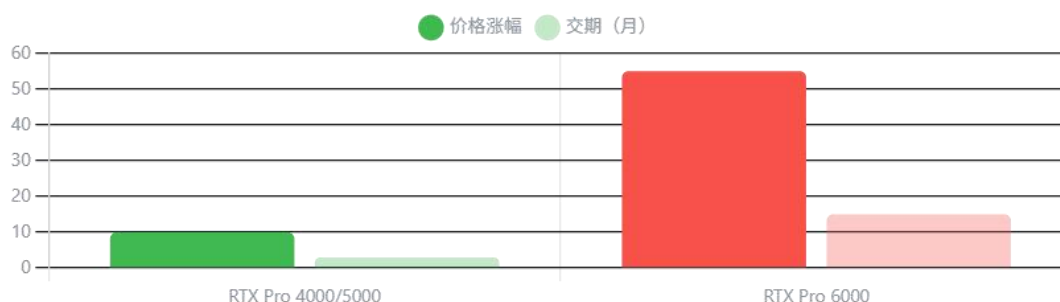
7 月 10 日，台积电通知英伟达、苹果、AMD 等客户，3/5/7nm 晶圆涨价 5-10%。仅 11 天后，再确认 2027 年全面涨价 5-10%，HPC 追加订单加收 10-15%溢价，2nm 至 28nm 全覆盖。此次定价逻辑的根本变化在于：AI 投资扩大后，供需失衡取代工艺成熟度成为定价主要驱动，代工行业进入卖方定价权时代。Q2 净利润 7,066 亿新台币 (+77%)；NVIDIA 2026 年预计贡献约 330 亿美元，占比 22%；苹果 A20 Pro 单颗代工成本或增 10-20 美元；2nm 晶圆约 3 万美元/片。



● 英伟达：GPU 供应紧缺，高端专业卡暴涨 50%+，交期 12-18 月

RTX Pro 6000 涨幅超 50%，交期 12-18 个月，现货紧缺——AI 大模型训练和影视渲染需求刚性。RTX Pro 4000/5000 仅涨 8%-12%，渠道备货充足。核心逻辑是 NVIDIA 将高端产能优先分配给 AI 数据中心，中低端专业卡供给相对充裕。

高端专业卡与中低端产品的价差和交期分化持续扩大，反映了 AI 算力需求对 GPU 产能分配的深度重塑。

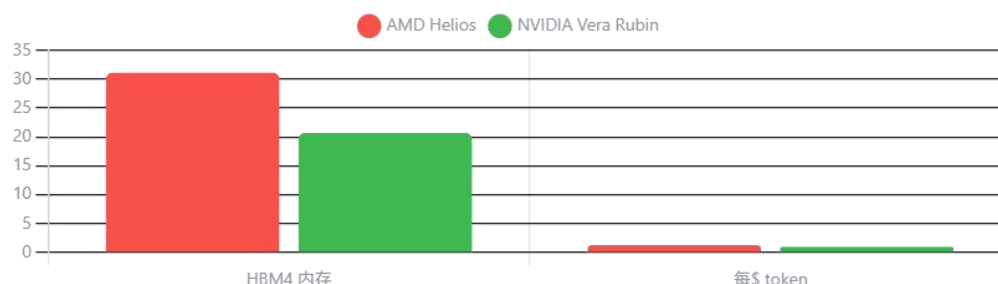


● 超威半导体：Helios 全面投产，MI455X 正面挑战英伟达

7 月 23 日，AMD 发布 Helios 平台：72 颗 MI455X GPU + 18 颗 EPYC Venice，单机架 2.9 exaFLOPS，HBM4 内存 31.1TB（较 NVIDIA Vera Rubin 高 50%），每美元 token 输出量高 30%。

7 月 28 日与 Anthropic 达成战略合作：Anthropic 拟部署 2 吉瓦 MI455X，AMD 承诺最高 50 亿美元战略投资。苏姿丰将 2030 年 AI TAM 上调至约 2 万亿美元。AMD 以开放生态（UALink 互连、ROCm 开源）对抗英伟达封闭 CUDA 体系，为市场提供第二个吉瓦级 AI 算力选项。MI455X 仍依赖台积电先进封装产能，供应爬坡节奏值得

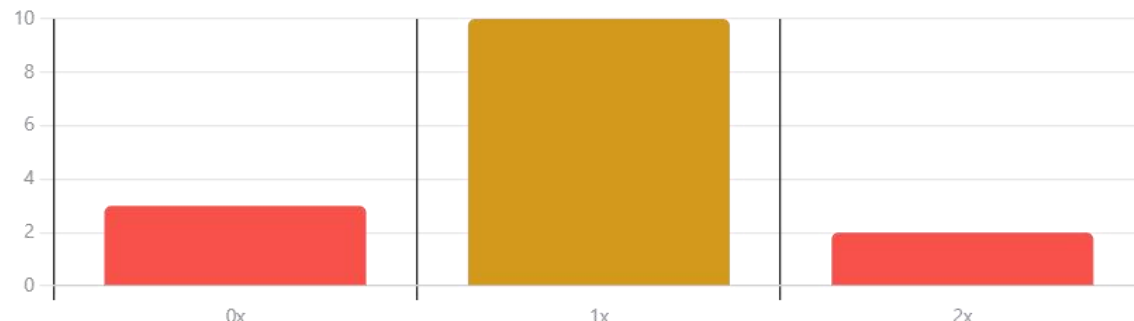
关注。



● 博通：AI 虹吸传统产能，PCI-E 与网络芯片结构性暴涨

PCI-E 5.0+产品（SS26、SS24 系列）交期无法满足 52 周；SS05 价格翻 2-3 倍，BCM54616 因停产叠加 AI 产能挤压翻了 10 倍。

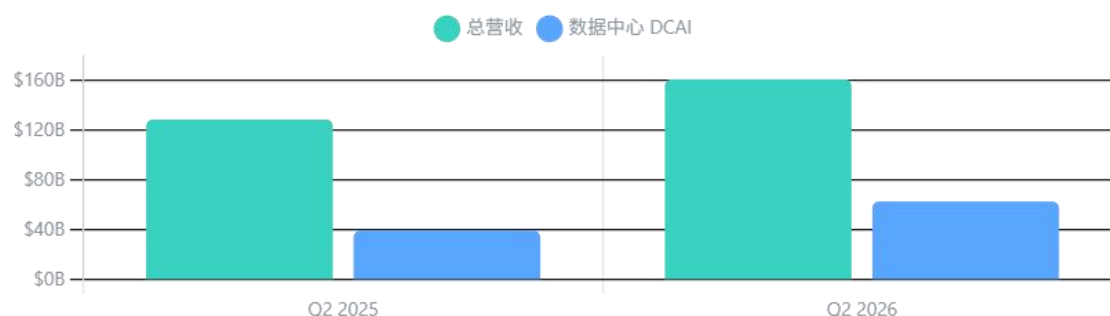
Broadcom 呈现典型的"双轨"格局：AI 定制芯片和网络交换芯片利润丰厚、产能饱和；传统 PCI-E 控制器和网络芯片产能被压缩，叠加部分料号停产，现货市场供需严重失衡。这种结构性矛盾的本质是产能分配向 AI 倾斜的外溢。



● 英特尔：Q2 营收创近 15 年最快增速，数据中心+59%

Q2 营收 161 亿美元（+25%），创 2011 年以来最快增速；数据中心业务（DCAI）营收 63 亿美元（+59%）创史上最强季度增幅。CEO 陈立武表示需求持续超过供应，已签 10 项 LTA。

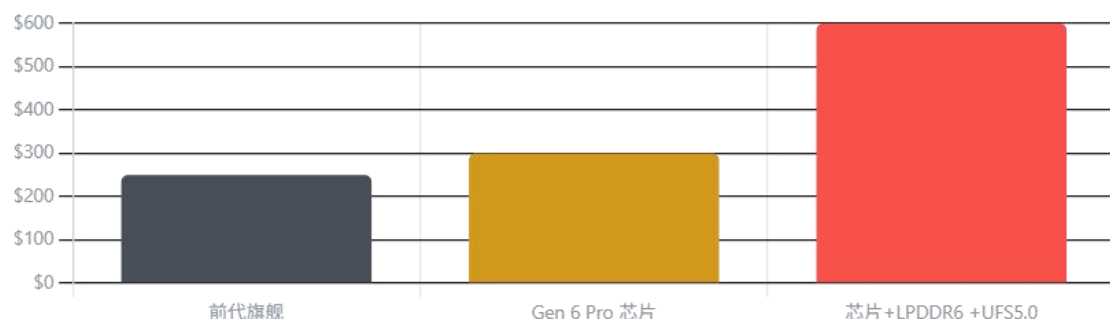
现货：6740P 约 9,800 美元，4 代 Xeon 4410Y/4410T 持续缺货。Xeon 6 系列成公司史上爬坡最快产品。AI 基础设施投资正从 GPU 向 CPU 扩散，供应紧张短期内难缓解。



● 高通：9 月起涨价两位数，旗舰芯片成本突破\$300

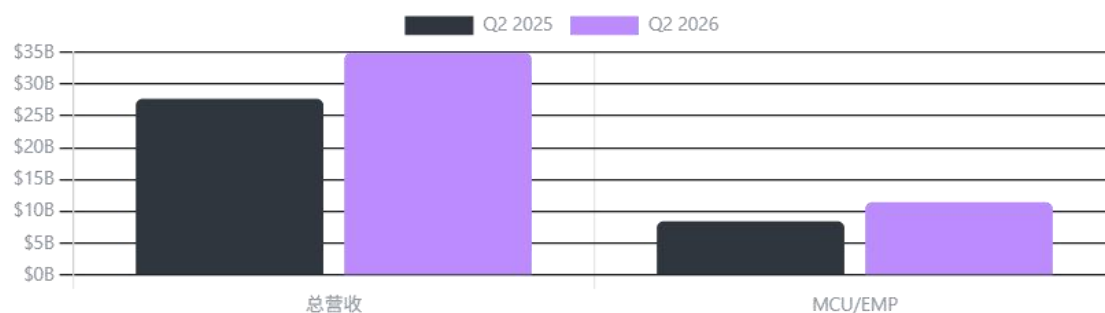
7 月 24 日，高通宣布 9/1 起全线涨价两位数百分比（>10%），公司表示已无法继续消化供应链成本上涨。骁龙 8 Elite Gen 6 Pro 单颗成本预计突破 300 美元（+20%），处理器+LPDDR6+UFS 5.0 组合成本约 600 美元。

Counterpoint 数据显示 Q2 全球智能手机出货量同比降 11%，高端芯片成本攀升与终端需求疲软形成张力。从台积电 2nm 晶圆到 ASML 光刻机，全产业链层层加码，成本最终传导至手机厂商和消费者。



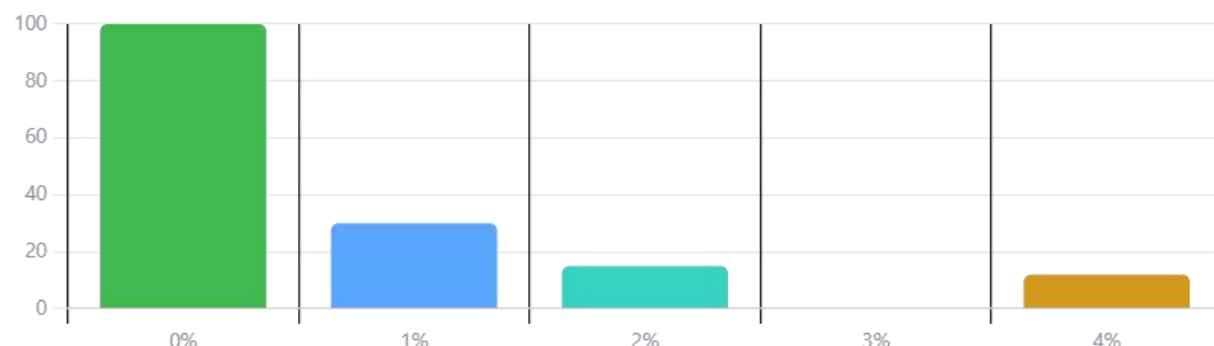
● 意法半导体：Q2 超预期，通用 MCU 与 AI 数据中心双引擎驱动

Q2 营收 34.9 亿美元（+26%），嵌入式处理（EMP/MCU）11.47 亿美元（+35.5%）为增速最高的分部。90nm/180nm 晶圆交期从 30 周延长至 52 周，book-to-bill 接近 2，库存周转天数降至 126 天。现货市场热门料号 STM32F103、STM32F405 涨势明显。AI 数据中心布局开始兑现——预计 2026 年该领域营收超 10 亿美元，2027 年稳超 20 亿美元。公司同时宣布扩大与 NVIDIA 在物理 AI 领域的合作。



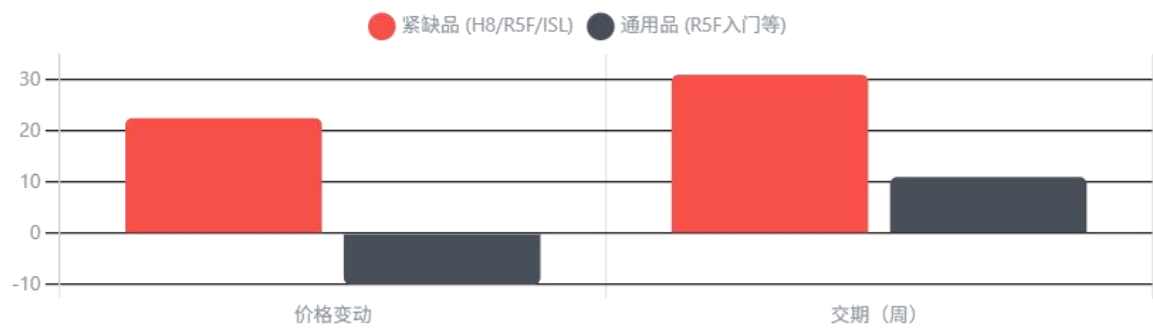
● 德州仪器：Q2 全面超预期，三大市场强劲驱动

Q2 营收 54.63 亿美元 (+23%)，净利 19.8 亿 (+53%)，EPS \$2.14。按市场分：工业+30%、数据中心翻倍、汽车中双位数增长。300mm 晶圆产能和 cleanroom 空间充裕，为持续增长提供可扩展基础。Q3 指引营收 56.5-61.5 亿美元，增长势头延续。TI 的增长结构反映出 AI 需求正从 GPU 算力层向电源管理、模拟信号链和嵌入式处理全面扩散。产能分配将持续向高利润的工业和数据中心产品倾斜，消费级和通用型模拟芯片供应改善仍需时日。



● 瑞萨：7 月涨价落地，现货市场两极分化

7 月 1 日 Renesas 正式执行年内第二轮涨价，覆盖车载 MCU、工业电源 IC、驱动芯片全品类，涨幅 8-15%。现货市场呈现明显分化：H8/300H 车规 MCU、R5F 高端车规、ISL 电源管理芯片溢价 15-30%，交期 24-38 周，供应紧张；通用 R5F 入门 MCU、运放、驱动 IC 价格回落，交期缩短至 8-14 周。背后逻辑是产能向车规和高可靠性产品集中，消费级及通用工业级因前期库存累积而相对宽松。



三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	动态	洞察
人工智能	Anthropic 通过与 TeraWulf 签订为期 20 年的租赁协议,获得了 401 兆瓦(MW)的 AI 算力容量, 预计将于 2028 年初投入运营。	长期人工智能基础设施投资将持续带动高性能计算 (HPC) 处理器、高带宽内存 (HBM)、网络芯片及先进封装需求。
	据报道, 英伟达拟通过约 2500 亿美元融资担保支持 OpenAI 俄亥俄州 10GW AI 数据中心项目, 总投资或超过 5000 亿美元。	AI 数据中心扩张持续支撑 GPU、电源管理芯片、网络芯片及先进封装需求。
汽车	福特及通用汽车加强与美光合作, 以确保下一代汽车存储芯片供应。	战略供应合作持续推动车用 DRAM、NAND 闪存及存储解决方案需求。
	Mobileye 携手 Stellantis 推进云增强型 ADAS 部署, 依托 REM 平台扩大应用。	ADAS 普及提升单车半导体含量, 推动 AI 处理器、视觉 SoC、传感器及车载存储芯片需求。
医疗	部分医疗级模拟元器件交期延长至约六个月, 精密运算放大器、隔离放大器及 ADC 供应持续受限。	交期延长提升医疗器械 OEM 对认证及长生命周期模拟元器件的供应风险。
	北美医疗半导体市场 2026 年预计达 85 亿至 95 亿美元, 进口依赖度仍高。	高度进口依赖凸显医疗级模拟芯片、传感器及处理组件供应商多元化与供应安全的重要性。
工业	瑞士工业 OEM 加速采用 AI 加速芯片,同时持续依赖进口半导体。	工业 AI 应用推动半导体需求从通用处理器转向 AI 专用计算平台。
	ADI 与 TI 将精密模拟产能转向 AI 产品, 成熟制程传统逻辑器件逐步面临停产。	成熟制程制造结构变化正增加工业模拟芯片及传统逻辑器件的供应风险。
机器人	宇树科技拓展 H1 Pro 人形机器人欧洲市场, 2025 年出货 5,500 台并占据全球 32.4% 市占率。	人形机器人规模化生产带动 AI 处理器、高性能计算及先进传感组件需求增长。
	Foundation Phantom 人形机器人转向采用 AMD Ryzen AI Embedded X100 处理器, 替代 NVIDIA 平台。	替代性 AI 计算平台扩大客户选择, 并推动机器人半导体生态竞争。
	AgiBot 加速采用国产半导体, MCU 及通信组件占硬件采购成本约三分之一。	中国人形机器人产业扩张推动本土半导体加速导入。

（一）人工智能

● Anthropic、OpenAI 与 AMD 锁定长期 AI 算力资源

Anthropic 与 TeraWulf 签署 190 亿美元、20 年期的数据中心租约，在肯塔基州建设 401MW 专用 AI 数据中心（2028 年初全面运营）。同期，OpenAI 将 2030 年算力预算上调至 7500 亿美元（较此前预估增长 25%），AMD 宣布向 Anthropic 投资 50 亿美元，部署 2GW AMD Instinct MI450 系列 GPU。三项承诺释放同一信号：超大规模客户正提前多年锁定专属算力，从“追单”转向“锁量”。采购端影响已可感知——HPC 加速器、HBM、高速网络 IC 及先进封装等关键器件将持续收紧。服务于 AI 应用的分销商须将需求持续高企纳入近期规划。

● 英伟达支持拟议的俄亥俄州 10GW AI 数据中心项目

据报道，英伟达（Nvidia）正商讨提供约 2500 亿美元的融资担保，以支持 OpenAI 租赁 SB Energy 公司拟在俄亥俄州建设的 10 吉瓦（GW）级 AI 数据中心园区的算力资源。该项目总投资预计将超过 5000 亿美元，目前相关融资及商业协议尚在商讨之中。这一拟建项目凸显了未来 AI 基础设施投资的巨大规模以及对配套算力的迫切需求。此类规模的项目需要海量的 AI GPU、网络芯片、电源管理 IC 及先进半导体封装技术。致力于构建 AI 基础设施的半导体买家应做好准备，应对高性能组件采购方面持续激烈的竞争。

（二）汽车

● 福特与通用锁定美光长期供货协议，保障下一代车型内存供应

福特（Ford）和通用汽车（General Motors）已加强与美光（Micron）的长期合作伙伴关系，以确保为未来汽车平台供应车用存储器及存储组件。双方达成的协议涵盖了针

对平台规格的紧密协作；与此同时，美光正持续扩建其位于弗吉尼亚州的工厂，以支持车规级 1-alpha 制程 DRAM 的生产。随着汽车电子架构日益向“软件定义”转型，这些举措凸显了长期供应规划的重要性。汽车整车厂（OEM）正从现货采购转向半导体长期采购模式，这不仅支撑了车用 DRAM、NAND Flash 及嵌入式存储产品的稳定需求，还推动了整个供应链更早做出采购承诺。

- **Mobileye 为 Stellantis 提供 ADAS 技术，REM 覆盖美欧 95% 以上道路**

Mobileye 与 Stellantis 达成合作，计划自 2027 年起在部分车型上部署“云增强型 ADAS”（高级驾驶辅助系统）。Mobileye 的 REM 平台覆盖了欧美地区 95% 以上的公共道路，通过整合来自 800 多万辆汽车及 340 亿英里行驶里程的数据，实现智能车道保持功能——即便在没有车道标线的道路上也能正常运作。此次合作推动了云增强驾驶技术在量产车型中的应用。ADAS 普及率的提升增加了单车半导体用量，从而带动了下一代驾驶辅助系统所需的 AI 处理器、视觉 SoC、车用存储器、图像传感器及连接芯片的采购需求。

（三）医疗

- **ADI 发出供应链预警：医疗级模拟芯片交期延长至 6 个月**

行业渠道报告显示，部分医疗级模拟元器件的交货周期已延长至约六个月，受影响的产品包括精密运算放大器、隔离放大器和模数转换器（ADC）。这些元器件广泛应用于患者监护、诊断及治疗设备中；由于受到监管和资质认证要求的限制，已获认证的元器件无法轻易更换。因此，未提前下单的客户可能面临交货不确定性增加的问题，而通过现货市场进行紧急采购则伴随着可追溯性及假冒伪劣产品的风险。医疗设备制造商可能需要更早下单，并密切监控已获认证的模拟元器件库存状况。供应紧张的局面尤为影响精

密放大器、隔离芯片、ADC 及其他医疗级元器件，因为更换这些元器件或重新进行资质认证可能会打乱生产计划。

● 北美医疗半导体市场面临进口高度集中的局面

据商业市场估算，2026 年北美医疗半导体市场的规模约为 85 亿至 95 亿美元。该地区的医疗设备生产高度依赖进口半导体，这些芯片广泛应用于诊断成像、患者监护、可穿戴设备及治疗系统等领域。这种依赖性使得制造商极易受到海外生产受限、物流中断及地缘政治局势变化的影响，对于那些需要医疗级认证及长期产品支持的元器件而言，风险尤为突出。鉴于这种进口依赖，在医疗级模拟 IC、传感器、MCU 及连接组件等领域实行多元化采购显得愈发必要。此外，原始设备制造商（OEM）在评估替代供应商时，也可能更加重视供应链的可追溯性与全生命周期保障。

（四）工业

● 瑞士工业原始设备制造商（OEM）转向人工智能加速芯片

包括 ABB、立达（Rieter）和博斯特（Bobst）在内的瑞士工业制造商，在工业自动化设备中不断增加 AI 加速芯片应用的同时，依然依赖进口半导体。随着 AI 赋能的检测、机器人及机器控制应用不断扩展，工业系统正从传统处理器转向能够处理更复杂工作负载的专用 AI 计算平台。工业 AI 的部署不仅带动了 AI 加速器、工业处理器、存储器及高速互连 IC 的采购增长，还促使原始设备制造商（OEM）针对关键计算组件采取半导体采购多元化策略。

● ADI 与 TI 将工业模拟芯片产能转向 AI 领域；传统逻辑芯片进入停产（EOL）阶段

ADI 和德州仪器（Texas Instruments）正将工业级精密模拟芯片的晶圆产能转向面向

人工智能 (AI) 的产品；与此同时，随着制造商持续削减对低利润成熟制程生产的投入，部分传统逻辑器件（如 74xx 系列）正步入停产阶段。这些变化延长了替代元器件的认证周期，工业级应用中的替代方案验证往往需要 6 到 12 个月的时间。成熟制程产能的缩减导致工业模拟 IC、传统逻辑器件及控制组件的供应日益紧张，因此，尽早完成认证并实施多源采购，对于保障生产连续性而言变得愈发重要。

（五）机器人

● 继上海 IPO 获批后，宇树科技 (Unitree) 在欧洲推出 H1 Pro

继其上海 IPO 计划获批后，宇树科技 (Unitree) 于 7 月 22 日正式在欧洲市场推出了 H1 Pro 人形机器人。该公司在 2025 年全球出货约 5,500 台人形机器人，占据了约 32.4% 的市场份额。H1 Pro 基于英伟达 (NVIDIA) 计算平台构建，而计划中的 IPO 所筹资金预计将用于支持未来的产能扩张、研发投入及供应链布局。随着人形机器人从原型开发阶段迈向商业化部署，采购模式正从工程样机阶段转向规模化量产采购。这一转变推动了机器人供应链对 AI 处理器、高带宽内存 (HBM)、图像传感器、运动控制芯片 (IC) 及电源管理器件的更高需求。

● Foundation 选用 AMD Ryzen AI Embedded X100 打造 Phantom 人形机器人

在 AMD “Advancing AI” 活动上，Foundation 宣布其 Phantom 人形机器人将采用 AMD Ryzen AI Embedded X100 处理器。这一决定取代了该公司此前基于 NVIDIA 的架构，并体现了 AMD 将 CPU、GPU、NPU 和 FPGA 技术整合为开放式机器人计算平台的战略。广泛采用替代性 AI 计算平台不仅能降低对单一芯片供应商的依赖，还能在嵌入式处理器、AI 加速器、存储器及配套连接设备等领域创造更多采购机会。此外，更加多元化的生态系统也为原始设备制造商 (OEM) 在选择长期机器

人硬件平台时提供了更大的灵活性。

- **AgiBot 扩大国内半导体应用**

AgiBot 确认, 包括 MCU 和通信组件在内的国产半导体目前约占其硬件采购成本的三分之一。随着人形机器人产能的扩大, 该公司正逐步以国产组件替代进口组件, 这反映了中国机器人产业整体的本土化趋势。本土化进程的加速正持续推动对国产 MCU、功率半导体、通信 IC 及传感器件的需求。随着中国机器人制造商对更多本土组件完成认证, 其采购策略预计将日益多元化, 这将重塑国内外半导体供应商之间的竞争格局。

四、存储行情

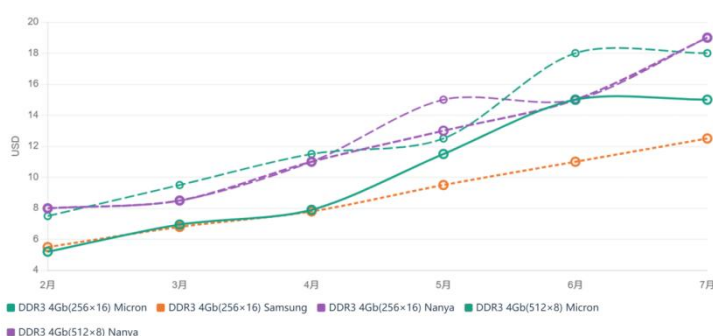
(一) 存储行情概览

- **DRAM:** Q3 合约价预计上涨 13-18%，供需缺口仍在加深。
- **DDR4:** 供应收紧推动合约价格上行，但部分现货规格已现回落迹象。
- **DDR5:** 颗粒报价上扬直接拉高内存条成本，叠加云服务商采购量增加，价格居高不下。
- **NAND Flash:** Q3 合约价涨幅受消费端放缓制约，预计在 10%–15% 区间。

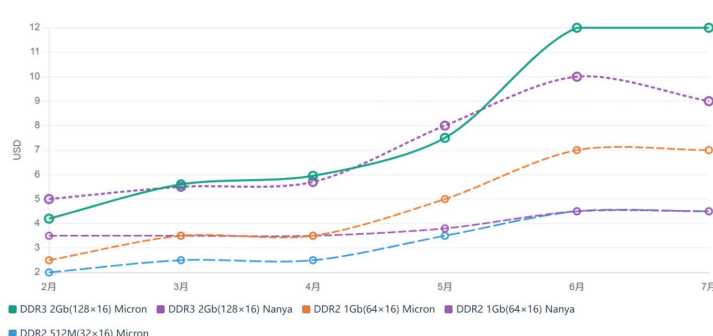
(二) 存储品类/品牌现货市场价格趋势

● DDR3 / DDR2 颗粒 — 老型号涨幅 100%~188%

- Micron 4Gb 涨幅 +188%: \$5.2 → \$15; Nanya 紧随其后 +127%~+154%。
DDR3 2Gb Micron \$4.2→\$12 (+186%)、DDR2 1Gb Micron \$2.5→\$7 (+180%),
缺货效应已传导至最老制程。



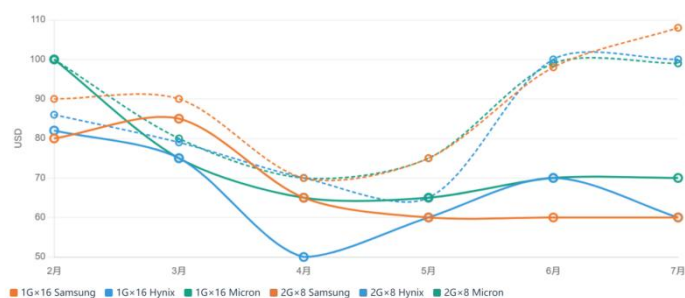
DDR3 4Gb 颗粒 (256x16 / 512x8) 各品牌价格走势 (2-7月)



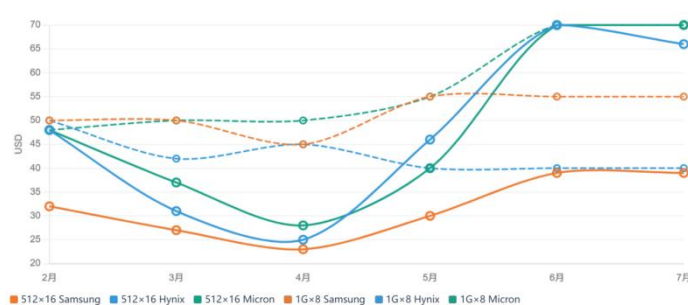
DDR3 2Gb / DDR2 1Gb / DDR2 512M 颗粒价格走势 (2-7月)

● DDR4 颗粒 — 大容量回落，小容量补涨，V 型走势

- 16Gb 高位回落：2-3 月 \$80-\$100 → 4 月急跌 → 6-7 月 2G×8 反弹至 \$100+，V 型走势显示供需拉锯。8Gb 补涨：512×16 Samsung +22%、Hynix +38%、Micron +46%，6 月跳涨明显，Q3 涨价传导中。



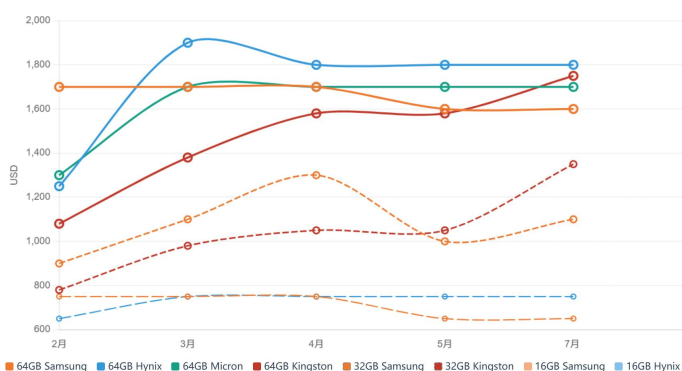
DDR4 16Gb 颗粒 (1G×16 / 2G×8) 各品牌价格走势 (2-7月)



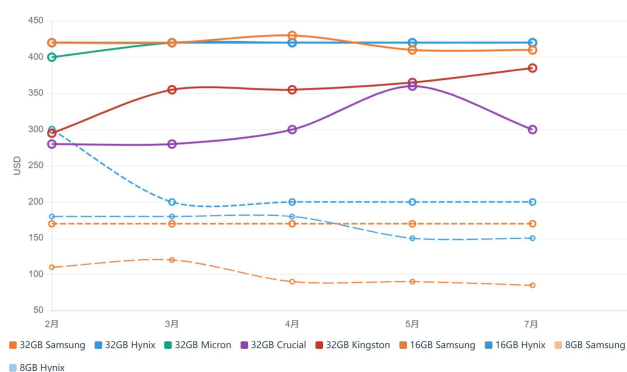
DDR4 8Gb 颗粒 (512×16 / 1G×8) 各品牌价格走势 (2-7月)

● DDR4 内存条 — 服务器内存条容量越大价格越高，消费级内存价格相对平稳

- 服务器内存条方面, Kingston 补涨 62%~73%: 二线品牌从低位追赶一线, 64GB +62%、32GB +73%。Samsung 64GB 逆势跌 -6%，品牌分化明显。消费级内存价格相对平稳。



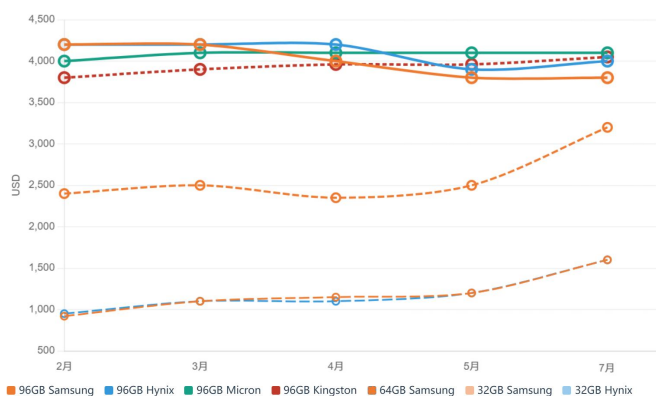
DDR4 服务器内存条 (64GB / 32GB / 16GB) 各品牌价格走势 (2-7月)



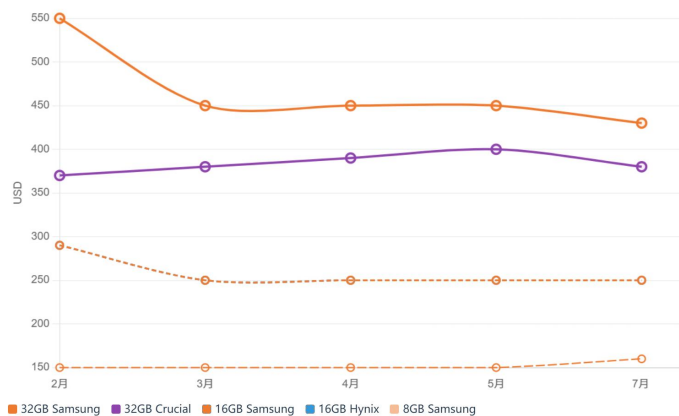
DDR4 PC 内存条 (32GB / 16GB / 8GB) 各品牌价格走势 (2-7月)

● DDR5 内存条 — AI 需求驱动，大容量高位震荡

- 32GB 6 月跳涨 +33%: Samsung \$1,200→\$1,600, AI 服务器推理需求拉动; 96GB 4-5 月松动后 6 月重回 \$4,000+。PC DDR5 持续降价: 32GB Samsung \$550→\$430 (-22%)、16GB \$290→\$250 (-14%), 消费级 DDR5 产能充足价格友好。



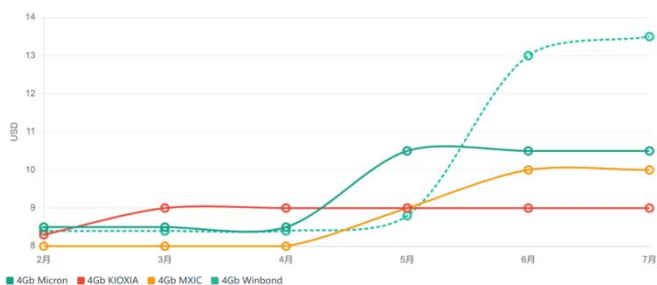
DDR5 服务器内存条 (96GB / 64GB / 32GB) 各品牌价格走势 (2-7月)



DDR5 PC 内存条 (32GB / 16GB / 8GB) 各品牌价格走势 (2-7月)

● NAND Flash SLC 颗粒 — 原厂议价权 + 替代需求 + 缺货传导

- Winbond 4Gb +61%: \$8.4→\$13.5, NOR Flash/NAND 替代需求推动; Micron/KIOXIA/MXIC 涨幅 8-25%。KIOXIA 1Gb 涨 +82%: \$2.2→\$4, 原厂议价权强势; Micron 2Gb +17%、1Gb +18% 稳步上行。



NAND 4Gb-SLC 颗粒各品牌价格走势 (2-7月)



NAND 2Gb / 1Gb-SLC 颗粒各品牌价格走势 (2-7月)

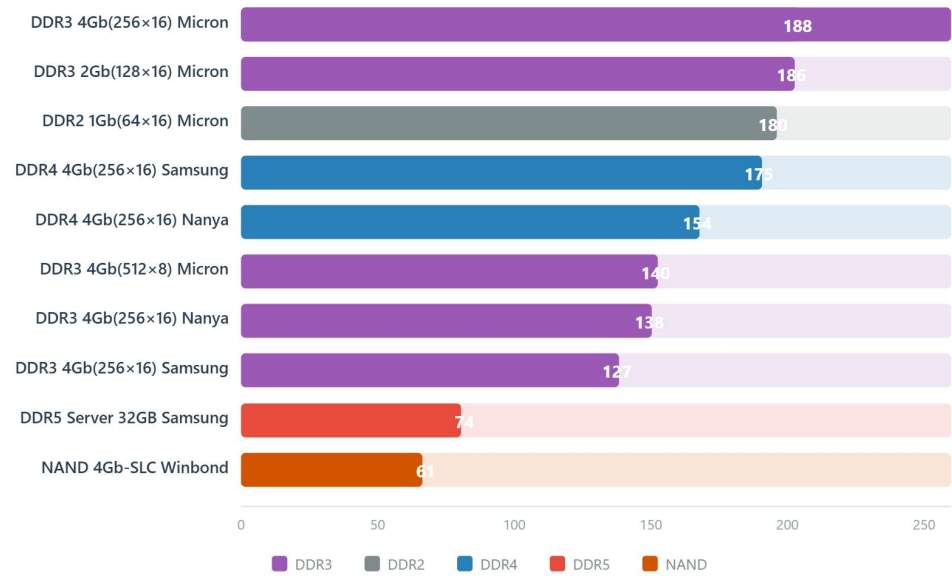
● 跨技术代际综合对比 — 涨幅热力图

➤ 累计涨幅热力图 — 技术代际 × 产品规格 × 品牌 (红色越深涨幅越大)

技术代际	产品规格	品牌	2月 \$	7月 \$	累计涨幅
DDR3	4Gb 256×16	Micron	\$5.2	\$15	+188%
DDR3	4Gb 256×16	Samsung	\$5.5	\$12.5	+127%
DDR3	4Gb 256×16	Nanya	\$8	\$19	+138%
DDR3	4Gb 512×8	Micron	\$7.5	\$18	+140%
DDR3	2Gb 128×16	Micron	\$4.2	\$12	+186%
DDR3	2Gb 128×16	Nanya	\$5	\$9	+80%
DDR2	1Gb 64×16	Micron	\$2.5	\$7	+180%
DDR2	512M 32×16	Micron	\$2	\$4.5	+125%
DDR4	16Gb 1G×16	Samsung	\$80	\$60	-25%
DDR4	16Gb 2G×8	Samsung	\$90	\$108	+20%
DDR4	8Gb 512×16	Hynix	\$48	\$66	+38%
DDR4	8Gb 512×16	Micron	\$48	\$70	+46%
DDR4	8Gb 1G×8	Micron	\$48	\$70	+46%
DDR4	4Gb 256×16	Samsung	\$8	\$22	+175%
DDR4	4Gb 256×16	Nanya	\$13	\$33	+154%
DDR5	Server 96GB	Samsung	\$4200	\$3800	-10%
DDR5	Server 64GB	Samsung	\$2400	\$3200	+33%
DDR5	Server 32GB	Samsung	\$920	\$1600	+74%
DDR5	Server 32GB	Hynix	\$950	\$1600	+68%
NAND	4Gb SLC	Winbond	\$8.4	\$13.5	+61%
NAND	4Gb SLC	Micron	\$8.5	\$10.5	+24%
NAND	1Gb SLC	KIOXIA	\$2.2	\$4	+82%

● Top 10 涨幅排名 (2月→7月累计)

➤ 按技术代际着色: DDR3 / DDR4 / NAND / DDR5



信息来源

[1] Commerce.gov. "Trump Administration Secures an Additional \$100 Billion U.S. Semiconductor Manufacturing Investment for a Total of \$265 Billion from TSMC." July 16, 2026.

[2] AMD. "AMD Advances AI Infrastructure Leadership with Helios Rack-Scale Platform and Instinct MI455X Accelerator." AMD Advancing AI 2026, July 23, 2026.

[3] AMD. "AMD and Anthropic Announce Strategic Partnership to Deploy up to 2 GW of MI455X AI Infrastructure." AMD Press Release, July 28, 2026.

[4] Chosun Biz. "SK Hynix SOCAMM2 Sales Accelerate in Q2 on AI Server Demand." Chosun Biz, July 29, 2026.

[5] Chosun Biz. "TSMC Notifies Key Clients of 5–10% Wafer Price Increase for 3nm, 5nm, and 7nm Nodes." Chosun Biz, July 10, 2026.

[6] CNBC. "SK Hynix Posts Record Second-Quarter Revenue but Misses Analyst Estimates Amid Conservative Pricing." CNBC, July 29, 2026.

[7] Counterpoint Research. "Global Smartphone Market Q2 2026: Shipments Drop 11% YoY to Lowest Q2 Level Since 2013." Counterpoint Research, July 2026.

[8] Euractiv. "EU 'Positive' on New 10% US Tariff Cap." July 24, 2026.

[9] European Commission. "Remarks by Commissioner Šefčovič on the EU-US Trade Relations." July 14, 2026.

[10] HSBC Global Research. "Samsung Electronics: Q2 DRAM and NAND Pricing Update." HSBC, July 2026.

[11] Intel Corporation. "Intel Reports Second-Quarter 2026 Financial Results: Revenue up 25%, Data Center Revenue up 59%." Intel Newsroom, July 24, 2026.

[12] Investing.com. "United States 10-Year Bond Yield." Investing.com, accessed July 24, 2026.

[13] Meininger's International. "EU-US Tariff Agreement Enters into Force." July 9, 2026.

[14] Nanya Technology Corporation. "Nanya Technology 2026 Second Quarter Earnings Conference Call." Nanya Technology Investor Relations, July

10, 2026.

[15] Newsis. "SK Hynix Long-Term Agreements Reshape Memory Supply Chain as B2B Sales Share Projected to Reach 70% by 2027." Newsis, July 29, 2026.

[16] NIST. "Department of Commerce Announces Direct Funding Agreement with Bosch for a \$225 Million CHIPS Program Award to Support Domestic Production of Silicon Carbide Semiconductors." July 13, 2026.

[17] NVIDIA Corporation. "NVIDIA and SK Group Announce Comprehensive Partnership; NVIDIA Secures Multi-Year AI Memory Supply from SK Hynix Potentially Valued at up to \$500 Billion." NVIDIA Newsroom, July 25, 2026.

[18] Qualcomm Incorporated. "Qualcomm Announces Double-Digit Price Increase Effective September 1, 2026." Qualcomm, July 24, 2026.

[19] Renesas Electronics Corporation. "Renesas Implements Price Adjustment Across Automotive MCU, Industrial Power IC, Driver IC, and Analog Signal Chain Product Lines." Renesas Press Release, July 1, 2026.

[20] Renesas Electronics Corporation. "Update on Operational Status of Kawashiri and Nishiki Factories Following the July 28 Kumamoto Earthquake." Renesas Press Release, July 29, 2026.

[21] Reuters. "Chinese and US Risks Mean EU Chip Sector Faces a 'Bleak Future,' Report Says." July 2, 2026.

[22] Reuters. "SK Hynix Q2 Earnings Fall Short as Conservative LTA Pricing Constrains Upside vs. Samsung." Reuters, July 29, 2026.

[23] Samsung Electronics Co., Ltd. "Samsung Electronics Announces Second Quarter 2026 Preliminary Earnings Guidance: Sales KRW 171 Trillion, Operating Profit KRW 89.4 Trillion." Samsung Newsroom, July 7, 2026.

[24] Samsung Electronics Co., Ltd. "Samsung Foundry Confirms HBM5 Base Die Will Adopt 2nm GAA Process Technology, Targeting 50%+ Performance Gain over HBM4E." Samsung Newsroom, July 27, 2026.

[25] Samsung Electronics Co., Ltd. and Broadcom Inc. "Samsung Electronics and Broadcom Sign Memorandum of Understanding for up to \$200 Billion Strategic Partnership Through 2030." Samsung Newsroom, July 25, 2026.

[26] SEMI. "SEMI Brings Semiconductor Industry Tax Leaders to Capitol Hill

to Urge Congress to Extend Section 48D Semiconductor Investment Tax Credit." July 22, 2026.

[27] Semiconductor Industry Association. "Global Semiconductor Sales Increase 9.2% Month-to-Month in May." Semiconductor Industry Association, July 6, 2026.

[28] Seoul Economic Daily. "SK Hynix HBM4 Achieves Yield and Quality Parity with HBM3E; HBM4E Mass Production Targeted for 2027." Seoul Economic Daily, July 29, 2026.

[29] SK Hynix Inc. "SK Hynix Reports Record Second Quarter 2026 Financial Results: Revenue KRW 79.32 Trillion, Operating Profit KRW 60.54 Trillion." SK Hynix Press Release, July 29, 2026.

[30] STMicroelectronics N.V. "STMicroelectronics Reports Q2 2026 Financial Results: Net Revenue \$3.49 Billion, Embedded Processing Revenue up 35.5%." STMicroelectronics Investor Relations, July 23, 2026.

[31] Texas Instruments Incorporated. "Texas Instruments Reports Second Quarter 2026 Results: Revenue \$5.46 Billion, Net Income \$1.98 Billion." Texas Instruments Newsroom, July 22, 2026.

[32] The New York Times. "TSMC Adds \$100 Billion to Its U.S. Spending Plan." July 16, 2026.

[33] Tokyo Electron Limited. "Tokyo Electron Provides Update on Safety Inspection at Koshi and Ozu Facilities Following Kumamoto Earthquake." Tokyo Electron Press Release, July 29, 2026.

[34] TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). "TSMC JASM Kumamoto Facility: Structural Inspection Complete, Operations Gradually Resuming Following July 28 Earthquake." TSMC Press Release, July 29, 2026.

[35] TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). "TSMC Plans 5 –10% Price Increase for Advanced Nodes; Additional 2027 Price Adjustment Confirmed." July 10 and July 21, 2026.

[36] U.S. International Trade Commission. "USITC Institutes Section 337 Investigation of Certain Dynamic Random Access Memory (DRAM) Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof (II)." July 15, 2026.

[37] USTR. "Fact Sheet: USTR Section 301 Action in Response to the Failure

of 60 Economies to Ban Imports Produced with Forced Labor." July 23, 2026.

[38] Wind. "费城半导体指数(SOX)数据." Wind 资讯, accessed July 2026.

[39] Wind. "全球制造业 PMI 数据." Wind 资讯, accessed July 2026.

[40] World Semiconductor Trade Statistics. "WSTS Spring 2026 Semiconductor Market Forecast." WSTS, 2026.

[41] Yonhap News Agency. "Lee Says Will Create 'Future Response' Fund Using Extra Tax Revenue." July 13, 2026.

[42] Yonhap News Agency. "Samsung, SK hynix to Build HBM Packaging Fabs in Chungcheong Region as Part of 392 tln Won in Total Investment." July 2, 2026.

[43] 共同社. 「高市内閣敲定『骨太方針』 推行积极财政」. 2026 年 7 月 21 日.

[44] 日本气象厅 (Japan Meteorological Agency) . 「令和 8 年 7 月 28 日 16 時 27 分頃の熊本県熊本地方の地震について」. 日本气象厅, 2026 年 7 月 28 日.

[45] 商务部 海关总署. 「商务部 海关总署公告 2026 年第 29 号 公布对氦气实施临时禁止出口管理」. 2026 年 7 月 10 日.

[46] TrendForce 集邦咨询. 「AI 需求持续旺盛, 村田、三星电机、太阳诱电三大日韩 MLCC 厂商 6 月出货量同步创近五年新高」. TrendForce 集邦咨询, 2026 年 7 月 28 日.

[47] 新华社. "China imposes temporary export ban on helium." July 10, 2026.

[48] 新华社. "China adds 14 EU entities to export control list." July 24, 2026.

[49] 英国《金融时报》. "China considers tighter export controls on AI models and chips, FT reports." July 21, 2026.

[50] 中央社. 「欧盟报告示警：芯片供应链受中美牵制 前景不乐观」. 2026 年 7 月 2 日.

[51] ChatForest. "Anthropic–TeraWulf Kentucky US\$19 Billion Data Center: 401MW Compute Builder Guide." July 2026.

[52] 36Kr. "OpenAI 2030 Computing Expenditure and AI Infrastructure Investment Developments." July 2026.

[53] Prensa Mercosur. "Nvidia and OpenAI May Reach Billion-Dollar Agreement for the World' s Largest Data Center." July 2026.

[54] Just Auto. "Ford Chip Supply Deal with Micron." July 2026.

[55] Just Auto. "Mobileye Cloud-Enhanced ADAS for Stellantis Models." July

2026.

[56] LXBCHIP. "ADI Issues Global Supply Warning: Core Industrial and Medical Analog Chips Extend Lead Times Up to 6 Months." July 2026.

[57] IndexBox. "North America Healthcare Semiconductor Market: Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights." 2026.

[58] UTmel. "SMD Components Outlook 2026: Supply, Lead Times and Sourcing Options." 2026.

[59] Automa. "Buy Industrial Automation Spare Parts Guide." 2026.

[60] The Robotics Media. "Unitree H1 Pro Europe Launch: First Three-Continent Rollout July 22, 2026." July 2026.

[61] Unite.AI. "Foundation Picks AMD Chips to Power Its Humanoid Robots." July 2026.

[62] Digital Phablet. "Agibot Begins Using Chinese Chips in Robots, Senior VP Confirms." July 2026.

[63] 国泰海通, 国泰海通: 存储供需缺口仍在加深 高盈利韧性支撑长景气周期, 2026.7.28

[64] 中華工商時報, 存储芯片迎涨价周期产业链承压与国产突围并行, 2026.7.7

[65] 新浪财经, 存储芯片涨价潮蔓延至消费端, 1TB 固态硬盘从 500 元涨至千元, 2026.7.6

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 7 月

360iC 安芯易



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有7个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

